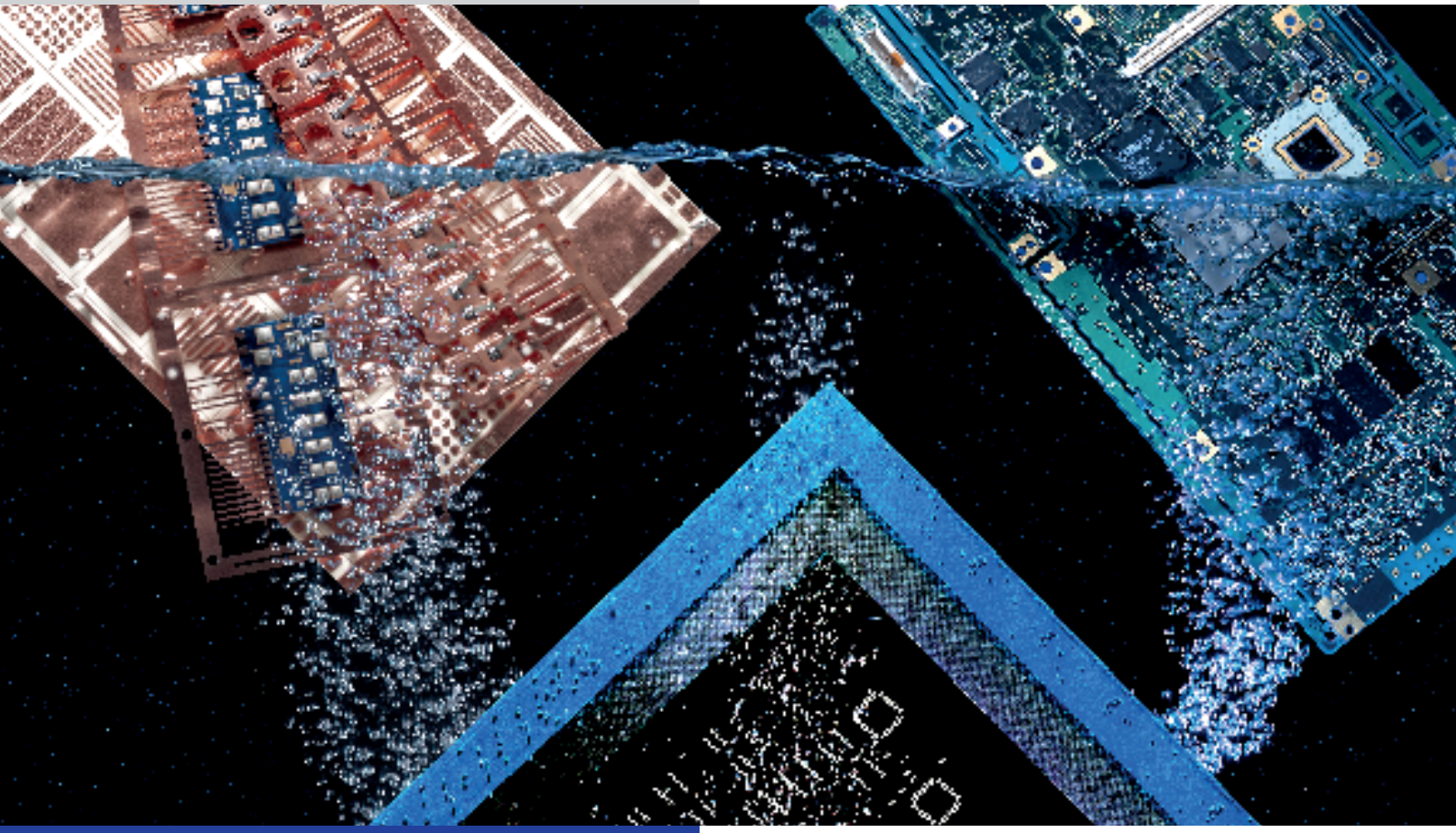
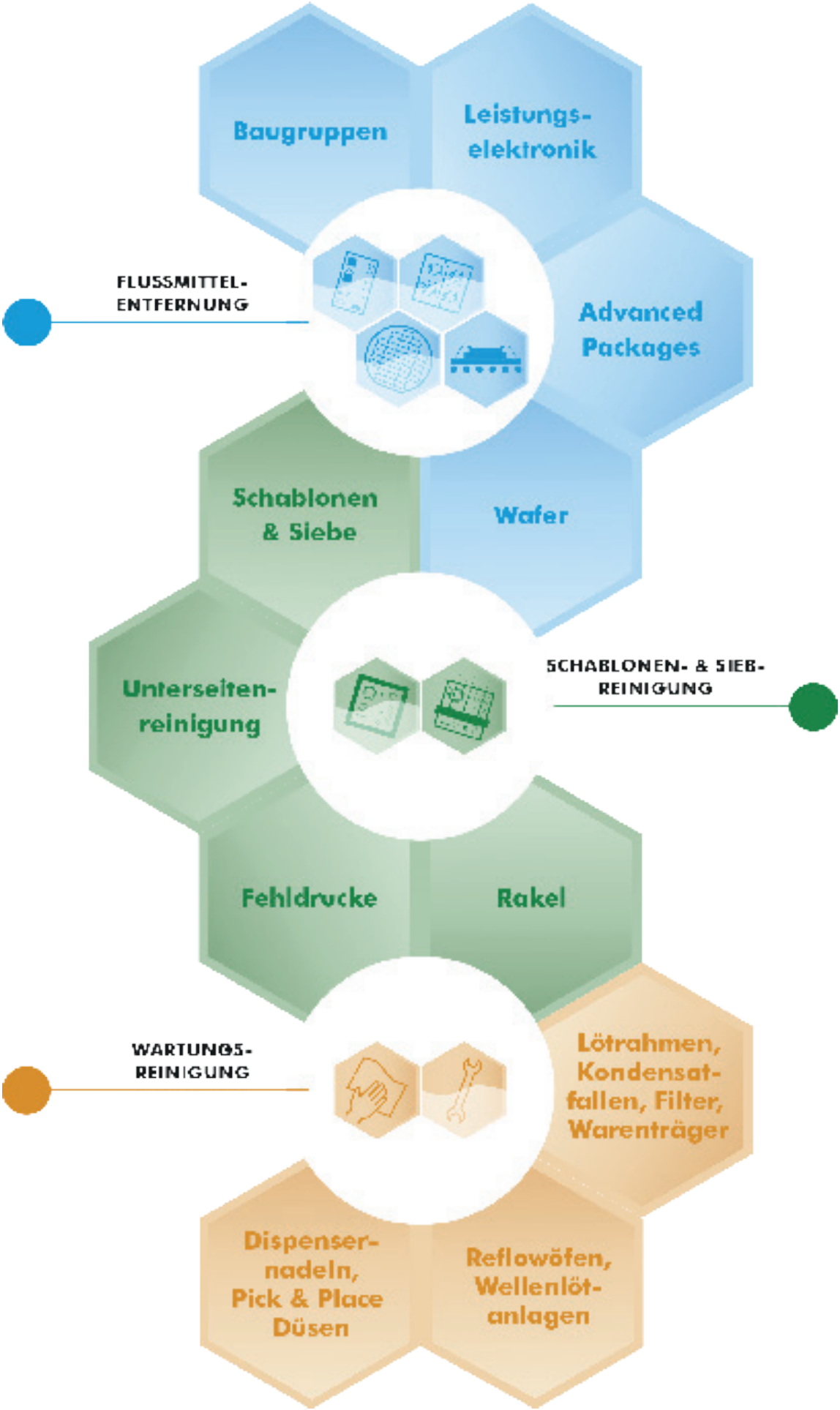
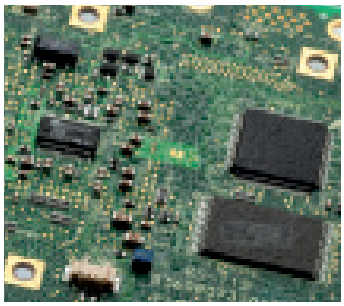


# Übersicht Reinigungsmedien

ZESTRON
High Precision Cleaning


Baugruppen
Leistungs-elektronik
FLUSSMITTEL-ENTFERNUNG
Advanced Packages
Schablonen & Siebe
Wafer
Unterseiten-reinigung
SCHABLONEN- & SIEB-REINIGUNG
Fehldrucke
Rakel
WARTUNGS-REINIGUNG
Lötrahmen, Kondensat-fallen, Filter, Warenträger
Dispenser-nadeln, Pick & Place Düsen
Reflowöfen, Wellenlöt-anlagen



# Baugruppenreinigung

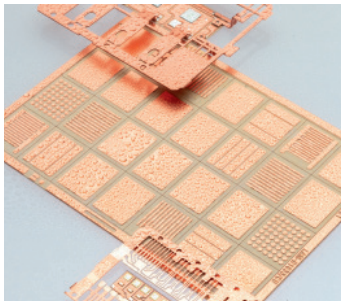
Für die Flussmittelentfernung von Baugruppen ist ein breites Spektrum von wasser- und lösemittelbasierenden Reinigungsmedien verfügbar. Das Produktportfolio bietet verschiedene Technologien, die eine exzellente Reinigungsleistung auf den neuesten Lotpasten und Flussmitteln erzielen und alle gängigen Reinigungsprozesse abdecken. Dazu zählen pH-neutrale sowie alkalische Produkte, die über eine hervorragende Materialverträglichkeit mit jeder Art von Bauteil und Substrat verfügen.

| Produkttechnologie | Reinigungsmedien | Anwendung | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PCB (FR4) / Multilayer | Flexible PCB | Keramik Hybrid | Aluminium Basis |
| MPC® (wasserbasierend) | VIGON® A 201 | ● | ● | ● | |
| | VIGON® N 600 | ● | ● | ● | ● |
| | VIGON® N 640 | ● | ● | ● | ● |
| | VIGON® N 680 | ● | ● | ● | ● |
| | VIGON® PE 180 | ● | ● | ● | ● |
| | VIGON® PE 190A | ● | ● | ● | ● |
| | VIGON® A 200 | ● | | ● | |
| | VIGON® US | ● | | ● | |
| | VIGON® A 250 | ● | | ● | |
| FAST® (wasserbasierend, Tensid) | ATRON® AC 205 | ● | ● | ● | |
| | ATRON® AC 207 | ● | ● | ● | |
| | HYDRON® WS 400 | ● | ○ | | |
| Lösemittel | ZESTRON® FA+ | ● | ● | ● | ● |
| | ZESTRON® VD | ○ | ○ | ● | ● |
| | ZESTRON® CO 150 | ● | ● | ● | ● |
| | ZESTRON® DW | ○ | ○ | ● | ○ |
| | VIGON® EFM | ● | | ○ | ● |

● Hauptanwendung – Produkt ist speziell für diese Anwendung entwickelt

○ Zusätzliche Anwendung – Produkt ist für diese Anwendung geeignet

Für weitere Informationen über Produkte zur Badüberwachung, Oberflächenanalyse und Reinigeraufbereitung siehe die Broschüre **Produkte zur Prozessoptimierung**.



# Leistungselektronik Reinigung

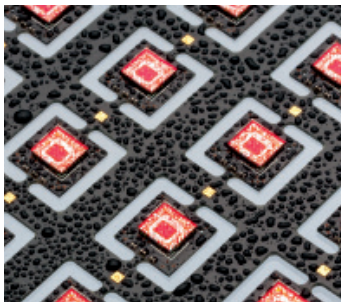
ZESTRONs Portfolio für Leistungselektronik, wie z.B. Power Module/ DCBs, Leadframes und Discrete Devices, beinhaltet wasser- und lösemittelbasierende Reinigungsmedien unterschiedlicher Technologien. Jeder Reiniger verfügt über eine exzellente Reinigungsleistung und Materialverträglichkeit. Alkalische sowie pH-neutrale Reiniger bieten Lösungen für jegliche Materialien, wie z.B. sensitive Metalle, Chips sowie Passivierungen, und bieten eine hervorragende Entoxidation von Kupfersubstraten und damit optimale Konditionen für nachfolgendes Drahtbonden und Vergießen.

| Produkttechnologie | Reinigungsmedien | Anwendung | | |
|---|---|---|---|---|
| | | High Power LEDs / Automotive | DCB / Power Modules / IPM / IGBT | Leadframes / Discretes |
| MPC® (wasserbasierend) | VIGON® PE 200 | ● | ● | ● |
| | VIGON® PE 215N | ● | ● | ● |
| | VIGON® PE 180 | ● | ● | ● |
| | VIGON® PE 190A | ● | ● | ● |
| | VIGON® N 600 | ○ | ○ | ○ |
| | VIGON® A 200 | | ○ | ○ |
| | VIGON® A 201 | ○ | | |
| | VIGON® A 250 | ○ | | |
| HYDRON® (einphasig, wasserbasierend) | HYDRON® SE 220 | ● | ● | ● |
| | HYDRON® SE 230A | ● | ● | ● |
| FAST® (wasserbasierend, Tensid) | ATRON® AC 205 | ○ | | |
| | ATRON® AC 207 | ○ | ○ | ○ |
| Lösemittel | ZESTRON® FA+ | ● | ● | ● |
| | ZESTRON® DW | ● | ○ | ● |
| | ZESTRON® VD | | | ○ |
| | ZESTRON® CO 150 | | ○ | ○ |

● Hauptanwendung – Produkt ist speziell für diese Anwendung entwickelt

○ Zusätzliche Anwendung – Produkt ist für diese Anwendung geeignet

Für weitere Informationen über Produkte zur Badüberwachung, Oberflächenanalyse und Reinigeraufbereitung siehe die Broschüre **Produkte zur Prozessoptimierung**.



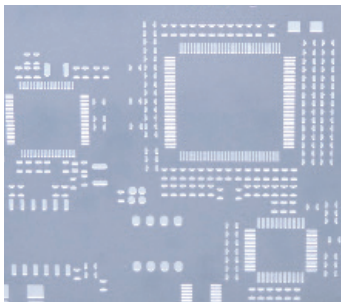
# Package und Wafer Reinigung

ZESTRON bietet diverse wasser- und lösemittelbasierende Reinigungsmedien für Advanced Packages, insbesondere zur Flussmittelentfernung nach dem Die Attach bei FlipChips, SiP und CMOS vor dem Underfill, Drahtbonden und Vergießen sowie nach dem Wafer-Bumping. Die hervorragende Reinigungsleistung unter Low-standoffs und die Verträglichkeit mit den verschiedensten Materialien sind die Kerneigenschaften der Reiniger. Sie sorgen für eine void-freie Underfillbenetzung und gute Drahtbondqualität und vermeiden Delamination und Wafer-Bump Angriffe.

| Produkttechnologie | Reinigungsmedien | Anwendung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SiP | Flip Chip BGA / 2.5/3D TSV | BGA | Einzelne Bauteile z. B. CoB, MEMS | CMOS / Kamera Module | Wafer |
| MPC® (wasserbasierend) | VIGON® N 600 | ● | ● | ● | ● | | |
| | VIGON® A 201 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | VIGON® A 250 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | VIGON® US | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HYDRON® (einphasig, wasserbasierend) | HYDRON® SE 220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | HYDRON® SE 230A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FAST® (wasserbasierend, Tensid) | ATRON® AC 205 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | ATRON® AC 207 | ● | ● | ● | ● | | |
| Lösemittel | ZESTRON® FA+ | ● | ● | ● | ● | ● | |

● Hauptanwendung – Produkt ist speziell für diese Anwendung entwickelt

● Zusätzliche Anwendung – Produkt ist für diese Anwendung geeignet



# SMT Schablonen-, Sieb- und Fehldruck-Reinigung

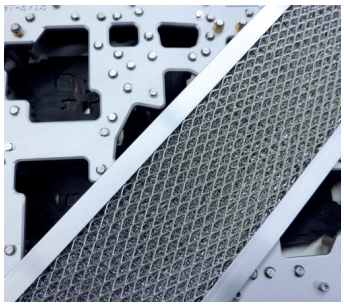
Zur Entfernung von Lotpasten von Schablonen, Sieben und Rakeln steht ein komplettes Sortiment an wasser- und lösemittelbasierenden Reinigungsmedien zur Verfügung, einschließlich spezifischer Lösungen für SMT-Kleber, Dickfilmpasten, Wärmeleitpasten sowie spezieller Verfahren wie die Unterseitenreinigung in SMT-Druckern oder die Fehldruckreinigung.

| Produkttechnologie | Reinigungsmedien | Anwendung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Flussmittel | Lotpasten | SMT-Kleber | Dickfilmpasten | Wärmeleitpasten | Unterseitenreinigung in SMT-Druckern | Rakel |
| MPC® (wasserbasierend) | VIGON® SC 200 | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| | VIGON® SC 202 | ● | ● | ● | | | | ● |
| | VIGON® SC 210 | ● | ● | ● | | | | ● |
| | VIGON® SC | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| | VIGON® UC 160 | | ● | | | | ● | |
| | VIGON® TC 150 | | | | | ● | | ● |
| HYDRON® (einphasig, wasserbasierend) | HYDRON® SC 300 | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| Lösemittel | ZESTRON® SD 100 | | ● | | | | ● | ● |
| | ZESTRON® SD 301 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |
| | ZESTRON® SW | | ● | ● | | | ● | |
| | ZESTRON® SD 300 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |

● Hauptanwendung – Produkt ist speziell für diese Anwendung entwickelt

● Zusätzliche Anwendung – Produkt ist für diese Anwendung geeignet

Für weitere Informationen über Produkte zur Badüberwachung, Oberflächenanalyse und Reinigeraufbereitung siehe die Broschüre **Produkte zur Prozessoptimierung**.



# Lötrahmen-, Kondensatfallen- & Werkzeugreinigung

ZESTRON bietet ein komplettes Sortiment an wasser-, tensid- und lösemittelbasierenden Reinigungsmedien für Lötrahmen, Lackierrahmen, Kondensatfallen, Warenträger, Lötöfen, Dispensernadeln und andere Maschinenteile. Eingebrannte Flussmittel und Ausgasungen von Baugruppen, die durch den Lötprozess verursacht werden sowie ungelötete Lotpaste, Lacke und SMT-Kleber werden somit sicher entfernt.

| Produkttechnologie | Reinigungsmedien | Anwendung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Maschinell | Manuell | Kondensatfallen, Filter | Lötrahmen, Lötmasken, Warenträger | Maschinenteile | Reflowöfen, Wellenlötanlagen | Dispensernadeln, Pick & Place Düsen | Lackierrahmen |
| FAST® (wasserbasierend, Tensid) | ATRON® SP 200 | ● | | ● | ● | ● | | | |
| | ATRON® SP 300 | ● | | ● | ● | ● | | | |
| | ATRON® SP 400 | ● | | ● | ● | ● | | | |
| wasserbasierend | ATRON® DC | ● | | | | | | | ● |
| MPC® (wasserbasierend) | VIGON® RC 303 | | ● | | ● | ● | ● | | |
| | VIGON® SC 210 | ● | | | | | | ● | |
| Lösemittel | ZESTRON® HC | | ● | | | | | ● | |

● Hauptanwendung – Produkt ist speziell für diese Anwendung entwickelt

● Zusätzliche Anwendung – Produkt ist für diese Anwendung geeignet

## Umwelt- & Arbeitsschutz

Alle Reinigungsmedien von ZESTRON sind konform mit RoHS I, II & III/WEEE, GHS/CLP und REACH und beinhalten keinerlei Substanzen der SVHC oder S.I.N. Liste. Es werden nur Rohstoffe mit höchster Arbeitssicherheit und Umweltverträglichkeit verwendet.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter: info@zestron.com

## Produkttechnologien & Marken

### Lösemitteltechnologie - ZESTRON

ZESTRON® Produkte sind moderne Lösemittel, die für high-end Reinigungsanwendungen entwickelt wurden. Sie bieten ein breites Prozessfenster für die Entfernung von diversen Verunreinigungen, eine lange Badstandzeit sowie die höchsten Arbeitssicherheitsstandards verglichen mit einfachen Alkoholen oder halogenierten Lösemitteln.

### FAST® Technologie - ATRON

ATRON® Produkte sind eine neue Generation von Tensiden basierend auf der Fast Acting Surfactant Technology. Sie bieten eine herausragende Reinigungsleistung, speziell bei kurzen Kontaktzeiten, und eine hohe Badbeladungskapazität im Vergleich zu konventionellen Tensiden.

### MPC® Technologie - VIGON

VIGON® Produkte basieren auf der Micro Phase Cleaning Technology. Sie sind wasserbasierende, tensidfreie Reinigungsmedien, die ein breites Prozessfenster für diverse Reinigungsanwendungen bieten. Ihre sehr lange Badstandzeit führt zu niedrigen Betriebskosten. Sie haben keinen Flammpunkt und niedrige VOC-Werte.

### Einphasige Technologie - HYDRON

HYDRON® Produkte sind wasserbasierende, einphasige Reiniger, die auch bei eingeschränkter (limitierter) Anlagentechnik über eine exzellente Einsatzfähigkeit bzw. ein breites Prozessfenster verfügen. Sie bieten eine sehr gute Spülbarkeit und können problemlos filtriert werden, um die Badstandzeit zu verlängern und Kosten zu senken.

## Weitere Informationen zum Produkt

- **Technische Information**
  Informationen über das Produkt, seine Anwendungen, Vorteile und physikalischen Daten
- **Material Compatibility**
  Übersicht bzgl. der Materialverträglichkeit mit Komponenten und Reinigungsanlagen
- **Sicherheitsdatenblatt**
  Informationen über die Zusammensetzung, Arbeitssicherheitshinweise, Transport und Lagerung
- **MPC® Technologie Informationsblatt**
  Informationen über die wasserbasierende Reinigungstechnologie
- **FAST® Technologie Informationsblatt**
  Informationen über die tensidbasierende Reinigungstechnologie
- **HYDRON® Technologie Informationsblatt**
  Informationen über die wasserbasierende, einphasige Reinigungstechnologie